

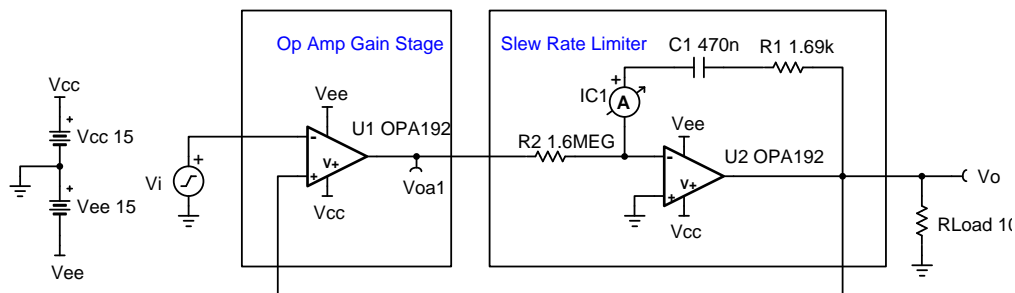
压摆率限制器电路

设计目标

输入		输出		电源		
V_{iMin}	V_{iMax}	V_{oMin}	V_{oMax}	V_{cc}	V_{ee}	V_{ref}
-10V	10V	-10V	10V	15V	-15V	0V

设计说明

该电路可控制模拟增益级的转换速率。该电路旨在用于对称的转换速率 不利。与选择用来实施转换速率限制器的运算放大器相比，所需的转换速率必须更慢一些。



设计说明

1. 必须检查增益级运算放大器和转换速率限制运算放大器，以确保稳定性。
2. 验证 C_1 的充电或放电电流需求再加上出自 U_2 的负载电流不会限制 U_2 的电压摆幅。

设计步骤

1. 设置转换速率并设置反馈电容器 C_1 的标准值。

$$C_1 = 470\text{nF}$$

$$SR = 20 \frac{\text{V}}{\text{s}}$$

2. 选择 R_2 的值，以设置实现预期转换速率所需的电容器电流。

$$SR = \frac{I_{C_1}}{C_1}$$

$$20 \frac{\text{V}}{\text{s}} = \frac{I_{C_1}}{470\text{nF}} \text{ where } I_{C_1} = 9.4 \mu\text{A}$$

$$\text{Gain stage op amp } V_{\text{sat}} = \pm 14.995 \text{ (typical)}$$

$$I_{C_1} = \frac{V_{\text{sat}}}{R_2}$$

$$9.4 \mu\text{A} = \frac{14.995\text{V}}{R_2}, \text{ so } R_2 = 1.595 \text{ M}\Omega \approx 1.6 \text{ M}\Omega \text{ (Standard Value)}$$

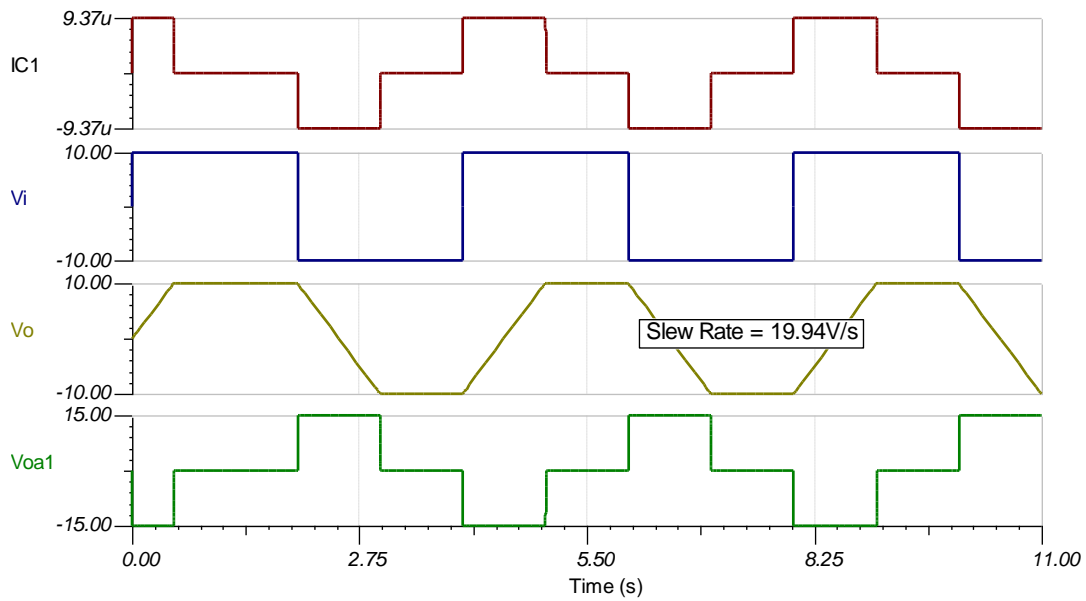
3. 补偿反馈网络，以实现稳定性。 R_1 会向 $1/\beta$ 网络添加一个极点。该极点的位置应使 $1/\beta$ 曲线在与开环增益曲线相交之前的一个十倍频趋于稳定（在本例中为 200Hz）。

$$f_p = \frac{1}{2\pi \times R_1 \times C_1} = 200\text{Hz}$$

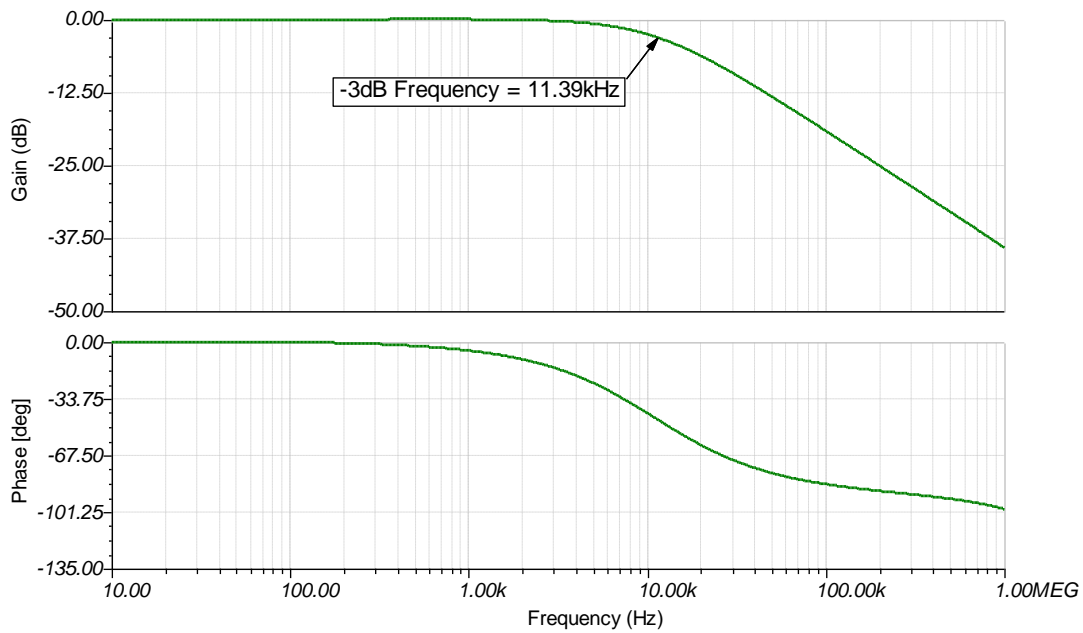
$$200\text{Hz} = \frac{1}{2\pi \times R_1 \times 470\text{nF}}, \text{ so } R_1 = 1.693 \text{ k}\Omega \approx 1.69\text{k}\Omega \text{ (Standard Value)}$$

设计仿真

瞬态仿真结果



交流仿真结果



设计参考资料

请参阅《模拟工程师电路说明书》，了解有关 TI 综合电路库的信息。

请参阅电路 SPICE 仿真文件 [SBOC508](#)。

请参阅 TIPD140，www.ti.com.cn/tool/cn/tipd140。

设计采用的运算放大器

OPA192	
V_{cc}	4.5V 至 36V
V_{inCM}	轨至轨
V_{out}	轨至轨
V_{os}	5 μ V
I_q	1mA/通道
I_b	5pA
UGBW	10MHz
SR	20V/ μ s
通道数	1、2、4
www.ti.com.cn/product/cn/opa192	

设计备选运算放大器

TLV2372	
V_{cc}	2.7V 至 16V
V_{inCM}	轨至轨
V_{out}	轨至轨
V_{os}	2mV
I_q	750 μ A/通道
I_b	1pA
UGBW	3MHz
SR	2.1V/ μ s
通道数	1、2、4
www.ti.com.cn/product/cn/tlv2372	

修订历史记录

修订版本	日期	更改
A	2019 年 2 月	缩减标题字数，将标题角色改为“放大器”。 向电路指导手册登录页面和 SPICE 仿真文件添加了链接。

重要声明和免责声明

TI 均以“原样”提供技术性 & 可靠性数据（包括数据表）、设计资源（包括参考设计）、应用或其他设计建议、网络工具、安全信息和其他资源，不保证其中不含任何瑕疵，且不做任何明示或暗示的担保，包括但不限于对适销性、适合某特定用途或不侵犯任何第三方知识产权的暗示担保。

所述资源可供专业开发人员应用 TI 产品进行设计使用。您将对以下行为独自承担全部责任：(1) 针对您的应用选择合适的 TI 产品；(2) 设计、验证并测试您的应用；(3) 确保您的应用满足相应标准以及任何其他安全、安保或其他要求。所述资源如有变更，恕不另行通知。TI 对您使用所述资源的授权仅限于开发资源所涉及 TI 产品的相关应用。除此之外不得复制或展示所述资源，也不提供其它 TI 或任何第三方的知识产权授权许可。如因使用所述资源而产生任何索赔、赔偿、成本、损失及债务等，TI 对此概不负责，并且您须赔偿由此对 TI 及其代表造成的损害。

TI 所提供产品均受 TI 的销售条款 (<http://www.ti.com.cn/zh-cn/legal/termsofsale.html>) 以及 [ti.com.cn](http://www.ti.com.cn) 上或随附 TI 产品提供的其他可适用条款的约束。TI 提供所述资源并不扩展或以其他方式更改 TI 针对 TI 产品所发布的可适用的担保范围或担保免责声明。

邮寄地址：上海市浦东新区世纪大道 1568 号中建大厦 32 楼，邮政编码：200122
Copyright © 2019 德州仪器半导体技术（上海）有限公司

重要声明和免责声明

TI 均以“原样”提供技术性数据（包括数据表）、设计资源（包括参考设计）、应用或其他设计建议、网络工具、安全信息和其他资源，不保证其中不含任何瑕疵，且不做任何明示或暗示的担保，包括但不限于对适销性、适合某特定用途或不侵犯任何第三方知识产权的暗示担保。

所述资源可供专业开发人员应用TI 产品进行设计使用。您将对以下行为独自承担全部责任：(1) 针对您的应用选择合适的TI 产品；(2) 设计、验证并测试您的应用；(3) 确保您的应用满足相应标准以及任何其他安全、安保或其他要求。所述资源如有变更，恕不另行通知。TI 对您使用所述资源的授权仅限于开发资源所涉及TI 产品的相关应用。除此之外不得复制或展示所述资源，也不提供其它TI 或任何第三方的知识产权授权许可。如因使用所述资源而产生任何索赔、赔偿、成本、损失及债务等，TI 对此概不负责，并且您须赔偿由此对TI 及其代表造成的损害。

TI 所提供产品均受TI 的销售条款 (<http://www.ti.com.cn/zh-cn/legal/termsofsale.html>) 以及ti.com.cn上或随附TI产品提供的其他可适用条款的约束。TI提供所述资源并不扩展或以其他方式更改TI 针对TI 产品所发布的可适用的担保范围或担保免责声明。

邮寄地址：上海市浦东新区世纪大道 1568 号中建大厦 32 楼，邮政编码：200122
Copyright © 2019 德州仪器半导体技术（上海）有限公司